

お知らせ

# 「OFC2026」に参加 次世代光通信用の複合ウエハーや回路基板などを展示

2026年03月03日

日本ガイシは2026年3月15日（日）から3月19日（木）まで、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスで開催される国際会議「Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) 2026」に参加します。「OFC」は光通信とネットワーク業界における世界最大規模の国際会議および展示会です。当社は、光通信において400Gbps/Laneの実現に向けた次世代の複合ウエハーや回路基板などを展示します。

## 展示会概要

展示会名	Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) 2026
期間	学会：2026年3月15日（日）～ 3月19日（木） 展示会：2026年3月17日（火）～ 3月19日（木）
会場	Los Angeles Convention Center 1201 South Figueroa St, Los Angeles, California 90015
当社ブース	ブース No. 1855
公式サイト	<a href="#">OFC</a>

## 出展概要

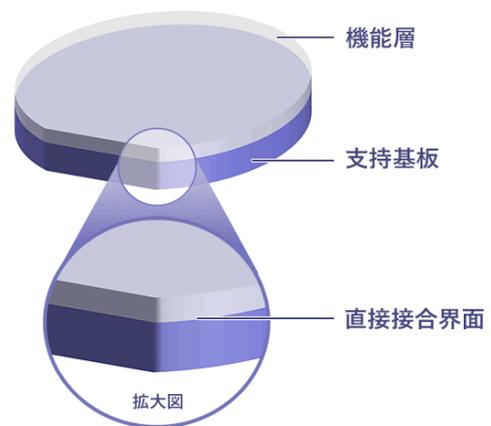
### 複合ウエハー

複合ウエハーは異種材料を貼り合わせた電子デバイス用基板です。二種類の基板を接着剤を使わず直接接合し、機能層を薄く高精度研磨することで、支持基板の物性である高絶縁、高熱伝導、低熱膨張、高剛性などを付加し、温度特性などの各種特性の改善を可能にします。光通信用変調デバイス、波長変換デバイス、高出力レーザーなどの基板として、小型、高速、低消費電力化に貢献します。本展示会では、TFLN、TFLT、PPLN、InP/SiCを展示します。

[ウエハー製品](#) [製品情報](#) >



複合ウエハー



複合ウエハーの構造

### 光通信向けTFLN複合ウエハー

光通信向けTFLN複合ウエハーは、ニオブ酸リチウム（LN）とベース基板を接合した複合ウエハーを精密研磨した高性能ウエハーです。これにより結晶ダメージのない薄膜LNを実現し、データセンターやコアネットワーク、メトロネットワークで使用する光変調デバイスの低消費電力化、小型化に貢献します。

本展示会では、新規開発品の8インチTFLN複合ウエハーを初公開します。従来4～6インチが主流だったTFLNウエハーにおいて、8インチへの大口径化は国内外でも最先端の成果

です。専門フォトニクスファウンドリとのプロセス互換性により生産スケールの拡大が可能となり、サプライチェーン上における量産委託先の選択肢を広げることに貢献します。



光通信向けTFLN複合ウエハー

## 高出力レーザー用InP複合ウエハー

高出力レーザー用InP複合ウエハーは、InPと高放熱材料であるSiCを直接接合したウエハーです。独自の接合技術と研磨技術により、InPウエハーに形成したレーザーによる発熱を抑制でき、テレコム用高出力レーザーやAIサーバーに今後適用されるCPO（Co-Packaged Optics）向けELS（External Laser Source）への採用が期待されています。

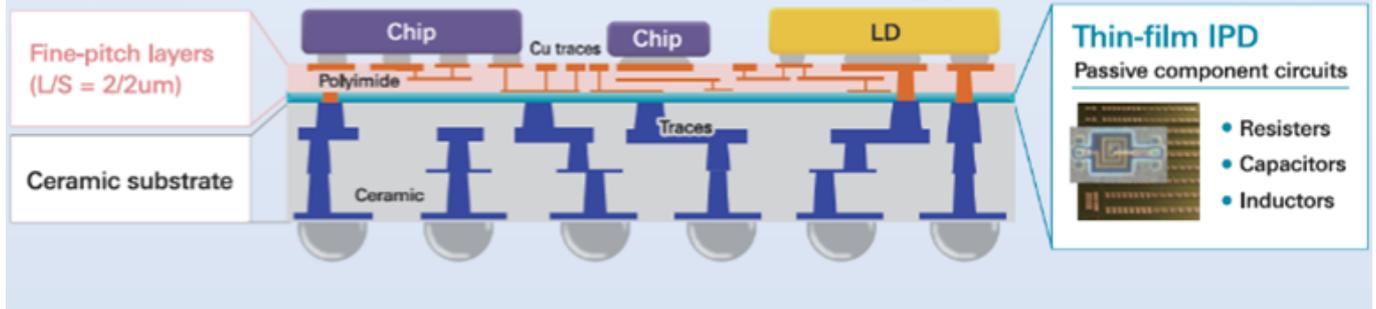


InP/SiCウエハー

## 光通信用回路基板

6G社会の創出に向け高速・大容量通信、低消費電力&高速処理対応が必要となる次世代通信技術。次世代の光通信用デバイスには高放熱や高密度配線の回路基板が必要となります。本展示会では、次世代通信用のOE（Optical Engine）、EML（Electro-Absorption Modulated Laser）、ELS（External Laser Source）用の基板を展示します。

## Thin Film Circuit & Multilayer Ceramic Substrate



OE用ハイブリッド基板

以上

[< 一覧へ戻る](#)